

第7回電材研究会の開催のお知らせと参加のお願い

電材研究会世話人会

「電気絶縁材料の高性能化及び次世代絶縁技術・システム」並びに「新規な機能材料創出に繋がる新市場ニーズ及び関連先端技術」等の情報入手・討論の場の提供を目指したミニ講演会の開催を実施、推進するために電材研究会を発足させ、これまで6回開催してきました。

以下に第7回電材研究会の開催のお知らせと参加のお願いを致します。

(1) 開催テーマ

自動車分野における電気機能材料の課題とS i C半導体の開発状況

(2) 開催日時

2011年3月11日 金曜日 14:00～17:00

(3) 開催場所

電気機能材料工業会 会議室

(4) 講演内容

1) 自動車分野における電気機能材料の課題と今後の展望

講演者所属氏名：(株)デンソー 材料技術部 機能複合材料室 課長 新帯 亮 氏

内容：エポキシ樹脂を中心にして、自動車分野での高機能化対応と今後の展望、

S i Cデバイスへの期待などについて

2) S i C半導体のインパクトと実装(材料)課題

講演者所属氏名：よこはま高度実装技術コンソーシアム 理事 宮代 文夫 氏

内容：なぜS i C半導体なのか、S i C半導体の開発状況などについて

(5) 参加費および参加資格

3,000円/人(会員に限る。)

(6) 申し込み方法

会社名、参加者名メールアドレス(または電話)をメールまたはFAXで事務局まで連絡ください。

(メール：jeia@vesta.ocn.ne.jp、 FAX：03-3829-4243)

(7) その他

討論会終了後、講師を交えて簡単な懇親会を予定しております。このような機会に、名刺交換・意見交換を通じてパイプを太くしていただくよう、計画しましたので是非ご利用ください。(費用は参加費に含まれております。)

電材研究会世話人会

代表：井上、世話人：金子、宮川、小林、須藤、神津